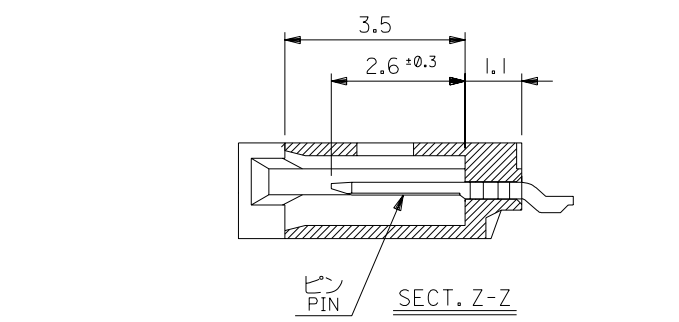
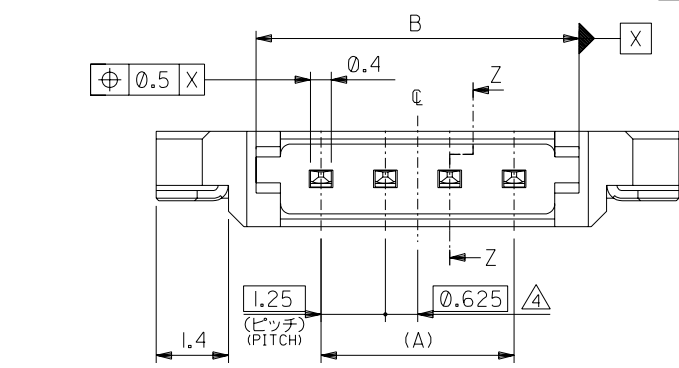
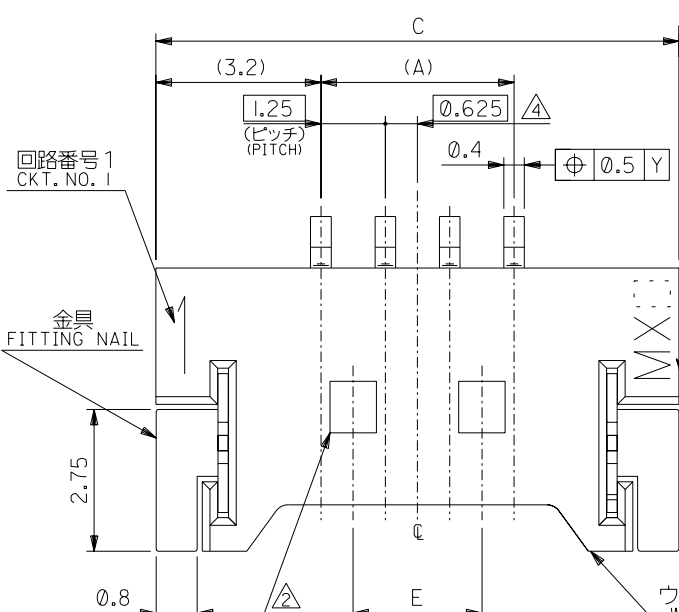
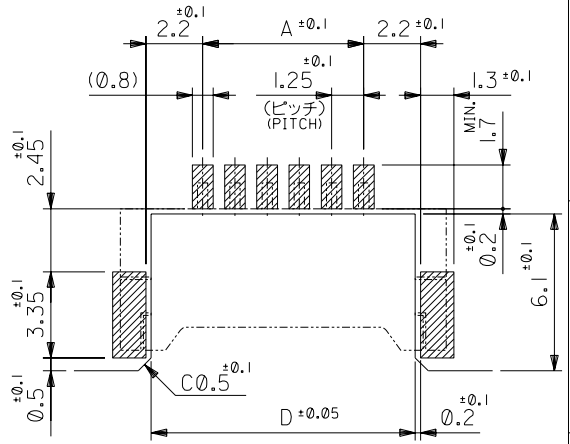


DWG. NO. SD-53779-001



注記 NOTES

1. 嵌合相手 : 51146 シリーズ  
MATES WITH : 51146 SERIES
  2. ロック窓は2、3極品は1箇所、4極品以上は2箇所とする。  
LOCKING WINDOW : ONE PLACE FOR 2 AND 3 CIRCUIT PRODUCTS AND TWO PLACES FOR MORE THAN 3 CIRCUIT PRODUCTS.
  3. 基準面  $\square V$  からのソルダーテールと金具の半田付け面のズレ量は、上方に  $0.05\text{MAX.}$ 、下方に  $0.15\text{MAX.}$  とし、相互のバラツキ量は  $0.1\text{MAX.}$  とする。  
MISALIGNMENT OF SOLDER TAIL AND FITTING NAIL FROM  $\square V$  : UPPER DIRECTION  $0.05\text{MAX.}$  : LOWER DIRECTION  $0.15\text{MAX.}$  : OFFSET BETWEEN UPPER AND LOWER  $0.1\text{MAX.}$
  4. 偶数極の製品に適用。  
APPLY EVEN CIRCUIT PRODUCTS.
  5. 材質 MATERIAL  
ウエハー WAFER : PPHS , UL94V-0  
ピン : リン青銅 (コンタクト部 : 金メッキ、テール部 : 錫メッキ)  
PIN : PHOS-BRO (CONTACT : GOLD PLATING, TAIL : TIN PLATING)  
金具 : リン青銅 (錫メッキ)  
FITTING NAIL : PHOS-BRO (TIN PLATING)
  6. 本製品は 53779-\*\*10 の鉛フリー品である。  
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53779-\*\*10.
- トレードマーク TRADE MARK

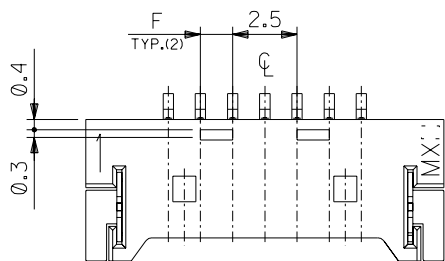


参考基板レイアウト  
RECOMMENDED P.C. BOARD PATTERN DIM. (REF.)

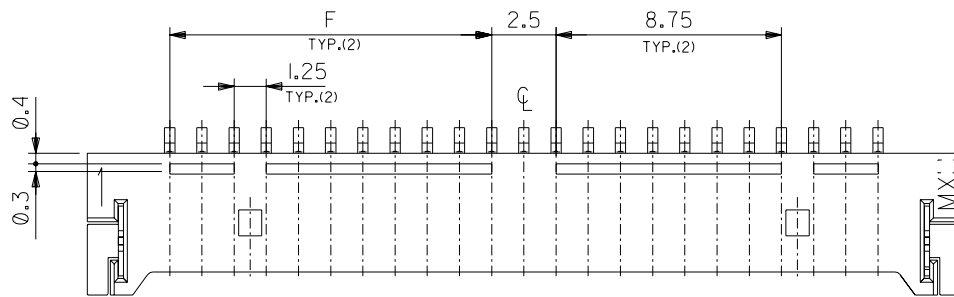
16.25	22.5	40.25	42.65	38.77	36.25	53779-3019	30	
15	22.5	37.75	40.15	36.27	33.75	-2819	28	
13.75	22.5	35.25	37.65	33.77	31.25	-2619	26	
12.5	22.5	32.75	35.15	31.27	28.75	-2419	24	
11.25	22.5	30.25	32.65	28.77	26.25	-2219	22	
8.75	22.5	27.75	30.15	26.27	23.75	-2019	20	
7.5	20	25.25	27.65	23.77	21.25	-1819	18	
6.25	17.5	22.75	25.15	21.27	18.75	-1619	16	
6.25	16.25	21.5	23.9	20.02	17.5	-1519	15	
5	15	20.25	22.65	18.77	16.25	-1419	14	
3.75	12.5	17.75	20.15	16.27	13.75	-1219	12	
2.5	10	15.25	17.65	13.77	11.25	-1019	10	
2.5	8.75	14	16.4	12.52	10	-0919	9	
1.25	7.5	12.75	15.15	11.27	8.75	-0819	8	
1.25	6.25	11.5	13.9	10.02	7.5	-0719	7	
--	5	10.25	12.65	8.77	6.25	-0619	6	
--	3.75	9	11.4	7.52	5	-0519	5	
--	2.5	7.75	10.15	6.27	3.75	-0419	4	
--	--	6.5	8.9	5.02	2.5	-0319	3	
53779-**19	--	--	5.25	7.65	3.77	1.25	53779-0219	2

MODEL NO.	F	E	D	C	B	A	MATERIAL NO.	CKT. 極数
-----------	---	---	---	---	---	---	--------------	---------

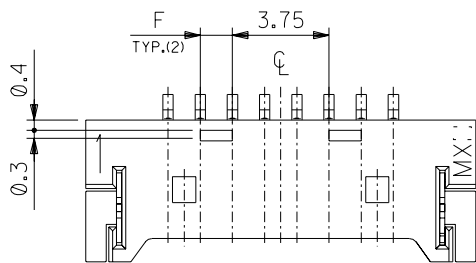
材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH	--	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE	--	TITLE 名称 1.25 WIRE TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y FOR S.M.T. (H=1.35) -LEAD FREE-	
被覆外径 INS. RANGE	--	DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV SD-53779-001 0	
DRAWN BY 04/03/02 H.KAWABATA	CHK'D BY 04/03/02 K.TOJO		
APP'D BY 04/03/02 M.SASAO	尺度 SCALE --		
角度 ANGLE	±3°		
30 以上 OVER	+0.3		
10 以上 30 未満 UNDER	+0.25		
10 未満 UNDER	+0.2		
一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	日付 DATE
	0	新規作成 (J2004-2798) RELEASED	H.K. 04/03/02 K.T.



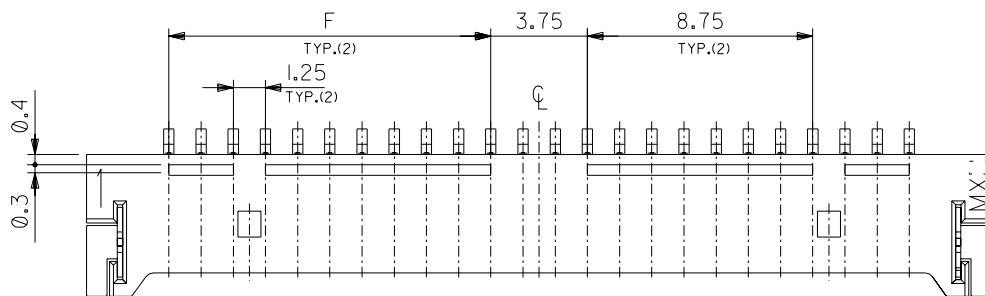
7~19極の奇数極に適用  
APPLY FOR ODD CIRCUITS OF 7~19



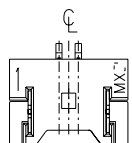
21極以上の奇数極に適用  
APPLY FOR ODD CIRCUITS 21~29



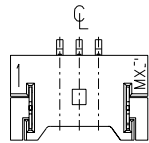
8~20極の偶数極に適用  
APPLY FOR EVEN CIRCUITS OF 8~20



22極以上の偶数極に適用  
APPLY FOR EVEN CIRCUITS 22~30



2 CKT.



3 CKT.

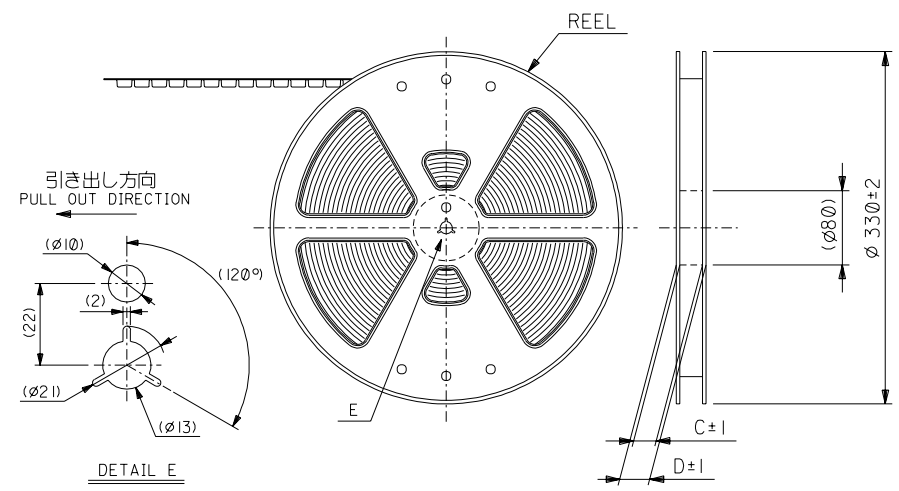
□ツク形状図  
LOCK CONFIGURATION

角度 ANGLE		±3°	材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
30 以上 OVER		+0.3	仕上げ FINISH		—#—	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
10 以上 30 未満 OVER UNDER		+0.25	適用電線範囲 WIRE RANGE		—#—	TITLE 名称 1.25 WIRE TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y FOR S.M.T. (H=1.35) -LEAD FREE-	
10 未満 UNDER		+0.2	被覆外径 INS. RANGE		—#—	DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV SD-53779-001 0	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		0	新規作成 RELEASED (J2004-2798)		H.K. K.T	DRAWN BY '04/03/02 H.KAWABATA CHK'D BY '04/03/02 K.TOJO	
記号 LTR			変更内容 REVISION RECORD		DR. CHK.	APP'D BY '04/03/02 M.SASAO	
					日付 DATE	尺度 SCALE	

DWG. NO. SD-53779-002

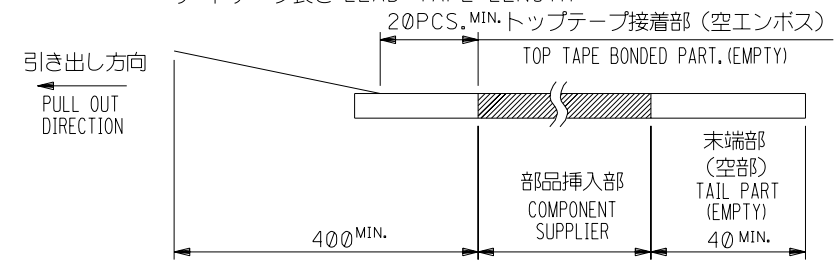
MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8 7 6 5 4 3 2 1

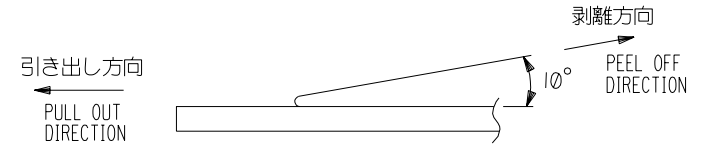


NOTES

1. 梱包数量：1500個/リール  
NUMBER OF CONNECTORS : 1500PCS/REEL
2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH



3. トップテープの剥離強度：0.1～1.3N {10～130gf}  
(剥離方向は下図参照)  
尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)  
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE : 0.1～1.3N {10～130gf}  
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG,)  
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.  
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED , DURING TRANSPORTATION.



4. 材料(MATERIAL)  
キャリアテープ(CARRIER TAPE)：ポリプロピレン(POLYPROPYLENE)  
トップテープ(TOPTAPE)：PET , PE , PEF  
リール(REEL)：ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>  
POLYSTYRENE (PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>
5. 本製品は 53779-\*\*90 の鉛フリー品である。  
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53779-\*\*90.

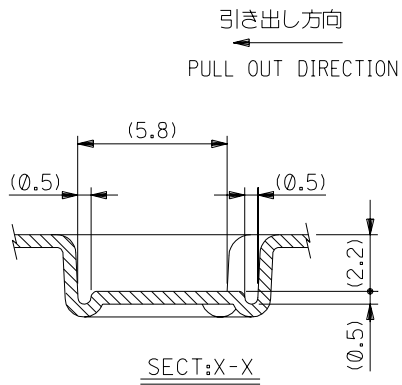
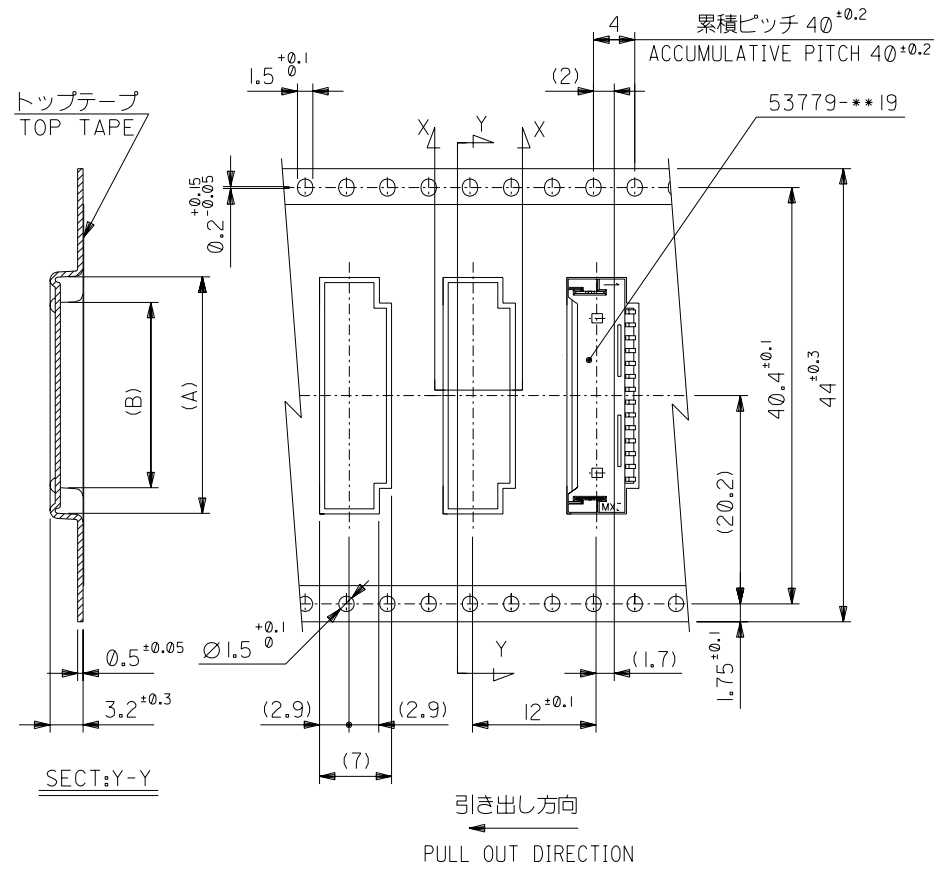
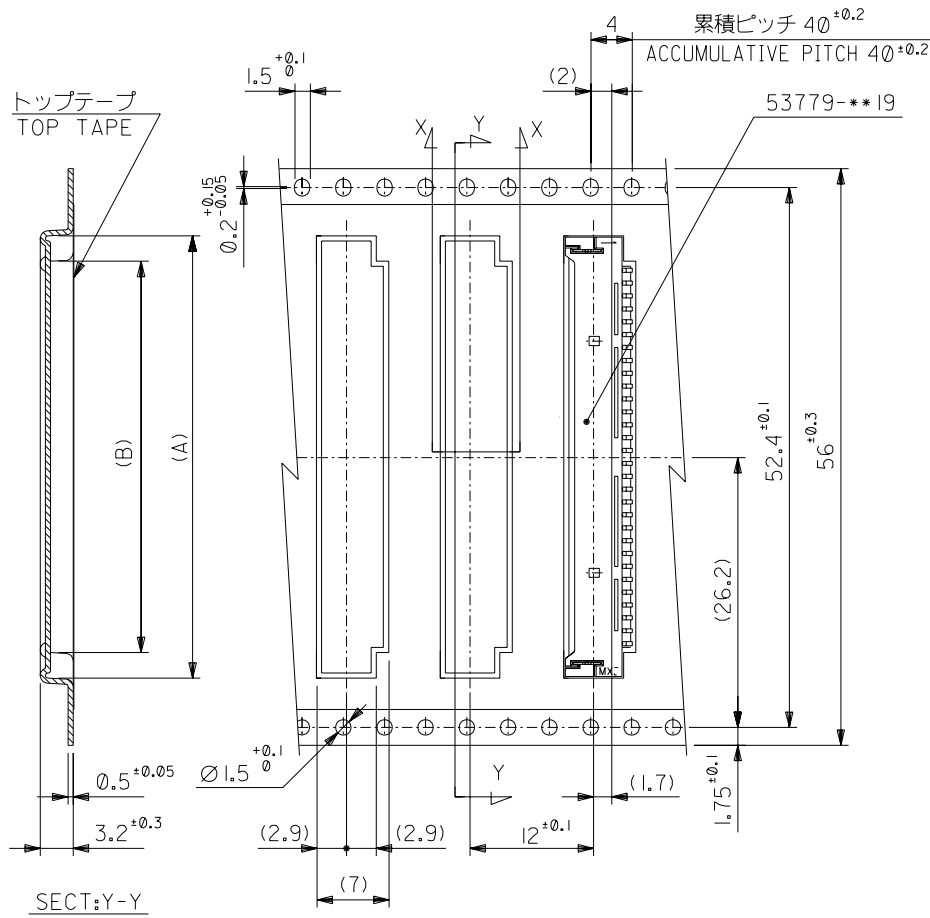
				材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTE		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
				仕上げ FINISH		—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
角度 ANGLE		±3°		適用電線範囲 WIRE RANGE		—		TITLE 名称 53779-**19 テーピング梱包 EMBOSSD TAPE PACKAGE FOR 53779-**19 -LEAD FREE-	
30 以上 OVER		+0.3		被覆外径 INS. RANGE		—		DWG. NO. (SHEET 1 OF 3) REV	
10 以上 30 未満 OVER UNDER		+0.25		DRAWN BY 04/03/02		CHK'D BY 04/03/02		SD-53779-002	
未満 10 UNDER		+0.2		H.K. K.		K. TOJO		0	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD		日付 DATE		尺度 SCALE	
		0		新規作成 RELEASED (J2004-2798)		M.SASAO		—	

8 7 6 5 4 3 2 1



DWG. NO. SD-53779-002

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



56	61.4	57.4	38	42.95	53779-3070	30
			33	37.95	53779-2670	26
			28	32.95	53779-2270	22
44	49.4	45.4	25.5	30.45	53779-2070	20
			19.25	24.2	53779-1570	15
			18	22.95	53779-1470	14
53779-***70	キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	C	(B)	(A)	MATERIAL NO. 種数 CRT.

材料 MATERIAL SHEET 1 OF 3 参照 REFER TO SHEET 1 OF 3	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
仕上げ FINISH	
適用電線範囲 WIRE RANGE	TITLE 名称 53779-***19 テープピンパッケージ EMBOSSED TAPE PACKAGE FOR 53779-***19 -LEAD FREE-
被覆外径 INS. RANGE	DWG. NO. (SHEET 3 OF 3) REV SD-53779-002 0
DRAWN BY 04/03/02 H.KAWABATA	CHK'D BY 04/03/02 K.TOJO
APP'D BY 04/03/02 M.SASAO	尺度 SCALE
角度 ANGLE ±3°	記号 LTR
30 以上 OVER ±0.3	変更内容 REVISION RECORD
10 以上 30 未満 OVER ±0.25	DR. CHK. 日付 DATE
10 未満 UNDER ±0.2	一般公差 GENERAL TOLERANCES

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION  
 本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。  
 EN-01C(032)MXJ-32